

未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細描述，見「業務—我們的發展戰略」。

[編纂]用途

我們估計，在[編纂]未獲行使的情況下，假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元(即指示性[編纂]範圍每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元的中位數)，經扣除估計[編纂]以及我們就[編纂]應付的其他費用及開支，[編纂][編纂]淨額將約為[編纂]百萬港元。

我們目前擬將[編纂][編纂]淨額按下文所載金額用作以下用途：

- [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於增強我們現有產品系列(如AI Scaler、STDI芯片、通用MCU及TMCU)的先進技術研發實力及產品迭代，以及開發用於AMOLED觸控芯片及音頻驅動器應用的下一代芯片。具體而言，我們計劃使用：
 - (1) [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]百萬港元研發高性能車規級芯片。我們將招聘25至35名模擬、數字、算法、應用及車規級功能安全合規等領域的專業人才，該等人才須於半導體行業擁有至少3年經驗，且期望薪資水平與業內同行相若。我們相信，具備相關專業背景及經驗且符合我們要求的候選人才數量充足。此外，我們的目標是將我們的產品組合由單核產品擴展至包括多核產品，且我們計劃開發基於RSIC-V架構的通用MCU，以滿足對電動汽車車域控制器及電池管理系統及具身智能的需求。我們將採購EDA工具及車規級可靠性測試設備，以支持我們的內部研發；
 - (2) [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]百萬港元開發高性能顯示芯片。我們計劃通過先進算法及機器學習推動圖像處理能力的迭代升級，並開發具有高分辨率選項的顯示芯片。我們的目標是將顯示芯片應用從手機顯示擴展至車載顯示器、筆記本電腦、平板電腦等顯示應用領域。同時，我們亦將擴展我們的產品組合，以加入AMOLED觸控芯片及音頻驅動器，結合我們的AI Scaler及STDI芯片，形成全面的產品組合，從而深化我們的客戶關係；
 - (3) [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]百萬港元開發先進的感知算法及多模態傳感器融合技術。我們的TMCU將進一步優化其算法，增強傳感精度及抗干擾能力。這將使我們的TMCU能夠在高溫、雨雪等惡劣條件下穩定運行，滿足汽車門把手及靈巧手等應用要求。同時，我們正優化端側AI推理框架，以創建一個全集成的技術生態系統；及
 - (4) [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]百萬港元開發具身智能及AI智能設備芯片組。我們將專注於機器人感控SoC的界定與發展，以在具身智能市場拓展新應用場景，例如機器人的運動控制及靈巧手的觸覺感知。我們將進一步迭代AI算法，並根據應用需求開發具身智能的SoC或運動控制芯片。

未來計劃及[編纂]用途

為開發高性能顯示芯片、先進感知算法及多模態傳感器融合技術，以及具身智能及AI智能設備芯片組，我們將使用所得款項購置數據測量、算法測試及迭代驗證所需的開發設備及平台(如用於芯片開發的FPGA原型平台及測試設備)，並部署小型服務器以支持端側AI算法訓練。此外，我們計劃在適當情況下有選擇地收購與計算模塊有關的成熟第三方知識產權(如DSP內核)，以加速開發週期並提升系統穩定性。在選擇成熟的第三方知識產權時，我們將考量知識產權的可靠性及其與我們芯片的兼容性與整合穩定性。根據弗若斯特沙利文的資料，半導體行業公司在芯片開發過程中採購成熟的第三方知識產權以避免重複開發並縮短開發週期屬行業慣例。

下文載列我們潛在的研發計劃及指示性上市時間表，旨在提升現有產品系列的先進技術與產品迭代，以及開發用於AMOLED觸控芯片及音頻驅動芯片的下一代芯片。

- **AI Scaler**。我們計劃開發融合升級技術的下一代AI Scaler芯片，包括智能圖像增強算法及具更高視覺無損壓縮率的壓縮算法，並預計於2026年開始量產。在此基礎上，我們計劃於2027年將AI Scaler算法技術延伸至車載顯示器應用，並開發用於SCCU的AI Scaler圖像處理芯片。
- **STDI芯片**。我們計劃開發支持高速eDP接口及適用於大尺寸顯示器的全高清解決方案的STDI芯片，並計劃於2026年量產。於2027年，我們計劃將STDI面板顯示技術延伸至車載顯示器應用，並開發融合區域調光等顯示增強技術的下一代車載顯示芯片。
- **AMOLED觸控芯片**。我們計劃於2026年完成用於AMOLED觸控應用的核心IP及關鍵技術的開發，隨後於2027年完成支持柔性AMOLED顯示器的觸控控制器芯片的開發及計劃量產。
- **音頻驅動芯片**。我們計劃於2026年開發汽車音頻功率放大器芯片並開始客戶送樣，預計於2027年實現量產，並逐步擴充相關產品組合。

儘管於往績記錄期間，我們的STDI芯片及通用MCU錄得毛虧損率，但我們認為繼續投資於這兩款細分產品的研發(包括動用部分[編纂][編纂]淨額)具有商業合理性及戰略重要性，原因如下：

- **預期透過產品迭代實現規模經濟**。我們正積極開發STDI芯片及通用MCU的新一代產品。隨著這些升級產品的推出以及我們持續努力提升市場滲透率，我們預期產量及銷量將逐步擴大。預期規模經濟的逐步實現將優化我們的單位製造成本，我們預期這最終將令該兩條產品線實現毛利率。
- **通用MCU的戰略和基礎作用**。我們的通用MCU是更廣泛MCU產品線不可或缺的基础技術。與通用MCU相關的持續研發活動及技術積累，對於開發其他更先進的MCU產品至關重要。舉例而言，我們的TMCU產品的成功開發及商業化正是基於通用MCU的核心技術基礎，且已成功實現正毛利率；若非我們對通用MCU持續進行研發投資，將不大可能實現該產品的成功開發與商業化。

未來計劃及[編纂]用途

- [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於建立一家年設計產能為2.0百萬顆的汽車電子模組組裝設施，服務汽車OEM及Tier 1供應商。基於以下假設：(i)我們的業務計劃及策略重心在提升我們組裝汽車電子模組的能力；(ii)當前市場條件下的競爭優勢，包括售價、銷售成本及我們在汽車行業獲取訂單的能力；及(iii)機器的經營成本及開支(主要包括維護成本、公用事業費用及折舊)，且市場、財政及經濟條件並無重大變動，董事預計盈虧平衡期約為3年，投資回報期約為6年。截至最後可行日期，我們並未開始規劃汽車電子模組組裝設施，亦未就其進行選址。根據弗若斯特沙利文的資料，對於無晶圓廠半導體公司(特別在汽車行業)而言，建立內部生產、組裝及測試設施屬行業慣例，以更適切支持客戶特定應用產品的開發，並確保產品質量的一致性及其可靠性。該等設施有別於晶圓製造線，主要專注於模組組裝、系統級測試及車規級驗證，而非半導體製造。我們將通過長期租賃的方式投資有關組裝設施。具體而言，我們計劃使用：
 - (1) [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]百萬港元開發基地運作系統及撥付營運資金需求。更具體而言，我們計劃建立涵蓋組裝至車規級測試的全流程生產線，其中(i)[編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]百萬港元用於土地及物業的長期租賃；及(ii)[編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]百萬港元用於撥付營運資金，例如用於採購晶圓以及芯片封裝及測試服務，並建立組裝設施的生產管理體系。該生產管理體系是可計劃、調度、執行及監控整個組裝流程的數字化平台，實現下單至製成品入庫各個階段的集中控制。該體系收集來自設備、工單及材料的實時數據並通過可視化儀表板展示該等數據，使管理層能夠監控生產狀態並實現對車間營運的透明控制。其亦集成流程參數控制、實時統計流程控制監控及全生命週期追溯，助力從源頭預防缺陷並確保質量問題可檢測、可管理及可追溯。通過利用數據作出的決策，包括智能生產調度、拉動式物料管理及設備綜合效率分析，該系統可助力縮短交付週期、降低存貨水平及提高設備利用率，進而提高整體營運效率。我們計劃於相關設備安裝及投產後開始部署該系統；及
 - (2) [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]百萬港元投資固定資產。我們計劃引進自動化光學檢測及功能電路測試設備、實行車規級溯源及MES系統，並升級我們的電磁兼容(「EMC」)實驗室，以確保產品質量及合規性。我們目前的內部實驗室配備有若干基本測試設備，我們亦部分依賴第三方測試機構進行EMC測試。隨著模塊組裝設施按計劃建立以滿足我們在測試效率、開發週期及成本控制方面不斷增長的業務需求，我們計劃升級EMC實驗室以加強我們的內部測試能力。實驗室升級後，我們將能夠在研發階段進行合規前測試，並在早期階段識別及解決潛在設計問題，從而提高產品質量並降低重複測試及重新設計的風險。此外，建立EMC實驗室將有助我們滿足適用的監管及認證要求(如中國強制性產品認證(CCC)及海外市場的相關國際標準)，同時有助達成汽車OEM及領先Tier-1供應商的供應商資格及審核要求，進而增強客戶信心並推動產品的推出及商業化。

未來計劃及[編纂]用途

該組裝設施將專門用於組裝我們主要應用於汽車行業的產品，如SCCU。我們認為將有足夠需求支撐我們建立內部組裝設施，主要原因是該設施擬通過提供需要緊密協作、快速產品驗證及嚴格車規級質量控制的特定應用電子模塊，為汽車OEM與Tier 1供應商提供服務。根據弗若斯特沙利文報告，在新能源汽車及其他領域持續釋放需求的推動下，預期全球MCU市場將由2025年約人民幣1,448億元增長至2030年約人民幣2,284億元，2026年至2030年的複合年增長率為10.1%。特別是，隨著智能座艙、自動駕駛及車身控制系統的滲透率提升，預期2026年至2030年全球車規級MCU的市場規模將以13.6%的複合年增長率增長，於2030年達約人民幣682億元。電容式方向盤離手檢測、觸摸門把手及多功能電椅系統等應用日益成為大眾市場車型的標配。該等應用通常需要集成模塊產品以及高效組裝與測試支持，從而為我們的內部設施帶來可持續的結構性需求。

儘管建立汽車模組的組裝設施可能令前期資本開支及經營成本增加，但隨著時間推移，我們能夠通過規模、流程優化及減少整合摩擦提升成本效率，從而提高利潤率。

- [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於提升我們的全球市場影響力以及擴展我們的國際銷售網絡。我們計劃積極發展全球銷售網絡以覆蓋亞太地區。具體而言，我們計劃使用：
 - (1) [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]百萬港元擴大位於香港的國際總部及業務中心、組建當地銷售、研發及運營團隊，以提升我們的區域管理能力。我們在香港的業務營運亦可作為區域協調平台，支持並擴大我們在東南亞及歐洲的業務布局。此外，依託香港作為國際商業與金融中心的地位，在香港設立本地總部將能更適切地支持我們的海外客戶接洽、技術支援、跨境項目執行與國際資金管理，同時促進國內業務與海外客戶及合作夥伴之間的溝通協調。我們將建立跨境法律團隊，以加強我們的合規、治理及國際業務執行能力。我們計劃通過展會、行業論壇及線上營銷加強在香港的品牌建設；
 - (2) [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]百萬港元構建全球化研發體系，其中，(i)[編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]百萬港元用於與亞太地區的頭部半導體製造商合作共同開發新產品。我們計劃通過聯合研發安排與亞太地區半導體製造商合作，而各方將根據安排在產品開發的各個階段展開合作。有關合作使我們能夠通過與國際認可的合作夥伴合作，提高產品的全球信譽，同時支持開發差異化產品功能，根據海外客戶需求量身定製，從而加強我們在國際市場的整體競爭力及定位。有關合作的詳細條款可能因具體項目而異。半導體產業的新產品開發通常涉及多個階段，包括設計、模擬、流片、測試、原型製作及認證，需要投入大量的前期投資。就估計支出而言，單次流片可能花費約人民幣3.0百萬元至人民幣5.0百萬元，而單個開發項目可能需要一至兩次流片。經計及流片成本以及EDA工具、測試、驗證、原型製作及認證等其他開發相關支出，開發單顆芯片的研發支出總

未來計劃及[編纂]用途

額約為人民幣20.0百萬元或以上。截至2026年4月，我們已成功與海外晶圓代工廠及半導體合作夥伴達成合作，以開發2款通用MCU及1款音頻功率放大器芯片，表明我們現有的產品組合實現升級及迭代增強。合作產生的知識產權將歸我們所有。我們計劃與有關製造商合作研發用於數據存儲及硬件安全的產品及技術，該等產品及技術具備差異化功能及性能，並拓展我們現有的產品組合；及(ii)[編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]百萬元用於招聘海外頂尖AI及芯片設計人才，加速推進下一代產品開發。我們計劃招聘5至10名相關人才；及

- (3) [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]百萬元拓展我們的海外銷售網絡及深化客戶關係，具體包括：(i)通過定期拜訪消費電子、汽車及具身智能行業的主要客戶，建立更主動、系統化的客戶互動機制，從而更好地把握市場需求及加強長期戰略合作。更具體而言，我們計劃在東亞及東南亞招聘10至15名具備相關行業經驗及當地市場知識的當地銷售人員及應用工程師，主要側重現場技術崗位，以提供現場工程支持，從而增強高效解決當地客戶提出的技術問題的能力。有關招聘主要覆蓋東亞及東南亞市場客戶。儘管我們的大部分客戶目前位於中國內地，但隨著我們的海外擴張，我們預期將在相關海外市場逐步建立及擴大客戶群。因此，招聘當地技術人員對支持有關海外擴張至關重要，因為彼等將提高我們有效應對當地客戶提出的技術問題的能力，根據當地市場需求定製產品及解決方案，並在客戶參與、產品驗證及商業化過程中提供及時的現場工程支持；及(ii)部署專責現場技術服務團隊，提供及時支持與售後服務。憑藉本地化團隊，我們可將區域網絡轉化為可持續的市場份額。

下表載列按年度分配[編纂]作上述用途的計劃時間表。

	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	總計
	(百萬元)					
增強我們的先進技術研發實力及產品迭代.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
興建一家汽車電子模組生產及組裝設施.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
提升我們的全球市場影響力以及擴展我們的國際銷售網絡.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

- [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]百萬元將用作營運資金及其他一般企業用途。

未來計劃及[編纂]用途

倘[編纂]定為低於或高於指示性發售價範圍的中位數，則上述[編纂]分配將按比例進行調整。在[編纂]未獲行使的情況下，假設[編纂]為[編纂]港元(即指示性[編纂]範圍的下限)，我們將收取[編纂]淨額[編纂]百萬港元，而假設[編纂]為[編纂]港元(即指示性[編纂]範圍的上限)，我們將收取[編纂]淨額[編纂]百萬港元。因[編纂]獲行使而收取的任何額外[編纂]亦將按比例分配至上述用途。倘[編纂]獲悉數行使，我們將收取[編纂]淨額[編纂]百萬港元(經扣除估計[編纂]以及我們就[編纂]應付的其他費用及開支，並假設[編纂]為每股[編纂]港元(即指示性[編纂]範圍的中位數))。

倘[編纂]淨額並未即時用作上述用途，只要被視為符合本公司最佳利益，我們會將[編纂]淨額存入持牌銀行或其他認可金融機構(定義見證券及期貨條例或其他司法權區的適用法律及法規)的短期計息賬戶。